

電子、電器封裝、灌注用矽膠介紹

一、產品簡介：

本公司生產電子、電器封裝、灌注用矽膠為一種兩液常溫、加溫硬化型，在主劑和硬化劑依適當比例充分混合後，反應形成一具柔韌彈性體、不會產生收縮和放熱現象，並且可以隔絕水氣、灰塵及達到吸震緩衝效果，亦是極佳的絕緣材，廣泛應用於轉換線圈、變壓器、高壓端子鑄件、通訊元件等。

二、主要特性：

- 1、具優異絕緣及防潮效果，能保護電子元件與電器設備。
- 2、具柔軟性有吸震和緩衝效果，具保護、防震、衝擊功能。
- 3、具有極佳的散熱效果，能保護電子元件與電器設備。
- 4、提供多種硬度及功能組合。



三、產品特性：

項目 \ 品名	CTS903-EYA	CTS4361A	CTS212A	CTS139A	CTS149A	CTS165A
顏色	黃	半透明	半透明	透明	透明	白
硬度(°A)	10	12	22	0↓	0	3
操作時間(分)	30	120	40	240	240	240
硬化時間(時)	4	9	7	0.5	0.5	0.5
抗拉強度(kgf/cm ²)	19.4	32	34	-	-	7
伸長率(%)	560	450	450	-	-	500
硬化條件	常溫	常溫	常溫	加溫	加溫	加溫

項目 \ 品名	CTS163A	CTS143A	CTS131A	CTS157A	CTS101A
顏色	白	透明	透明	半透明	透明
硬度(°A)	10	13	20	35	40
操作時間(分)	240	240	40	240	120
硬化時間(時)	0.5	0.5	10分	0.5	2
抗拉強度(kgf/cm ²)	20	31	35	41	56
伸長率(%)	510	450	300	400	350
硬化條件	加溫	加溫	加溫	加溫	加溫

電子、電器封裝、灌注用矽膠介紹

四、使用方法：

1. 將主劑先攪拌約 1~2 分鐘，轉速約 200~400rpm。
2. 選擇合適容器，加入主劑與硬化劑於 3~4 倍大的容器內。
3. 將混合物(主劑與硬化劑)放入真空器抽真空約 1~2 分鐘，排氣約 2 次。
4. 取出倒出使自然流平(或用灌注機灌注)。
5. 自然乾燥後脫膜(或加溫快速硬化)。

五、儲存：

為確保矽膠能維持良好品質和安定性，應將密封儲存於小於 30°C 之乾燥環境，使用後應加蓋，切勿和水氣接觸以防變質，本產品保存期為 1 年。

六、運輸：

按非危險品運輸，本公司備有週全之物質安全資料表可供客戶使用。

七、另附：

本公司產品除電子、電器封裝、灌注矽膠外，還可以提供以下產品及這些產品的全套技術。

製模用矽膠、電子、電器封裝灌注、防潮、絕緣用環氧樹脂、聚胺酯、金屬灌注用矽膠、原模開發用矽膠、填縫用矽膠、網印用矽膠、防滑避震用矽膠。

如需要配合產品開發及索取詳細說明書及樣品，敬請來電聯絡。